

第10回 未来科学オープンセミナー

未来の産業を担う三次元積層半導体(3D-IC)の現況と今後の展開 —東北大学3D-IC研究開発拠点「GINTI」の活動成果より—

未来科学オープンセミナーでは、東北大学未来科学技術共同研究センターで行っている研究成果や独創的な開発研究を、オンライン配信によって分かりやすくご紹介いたします。

第10回は、福島誉史准教授の三次元積層半導体(3D-IC)研究の現況と今後の展開について紹介します。

【プログラム】

15:15 webサイトオープン

15:30 配信開始、イベント趣旨、注意事項説明

15:35 講演

東北大学大学院工学研究科
(未来科学技術共同研究センター 兼務)
准教授 福島 誉史

講演題目

未来の産業を担う三次元積層半導体(3D-IC)の現況と今後の展開
—東北大学3D-IC研究開発拠点「GINTI」の活動成果より—
(講演の合間と終了後に質疑応答)

17:00 終了

福島准教授の研究と講演の内容

人工知能社会の本格的な到来により、HPCやモバイル用途だけではなく、ニューロコンピュータや量子コンピュータ、ポスト5Gなど、ロジック/メモリ、アナログ/デジタル混載の新しい半導体システムに対する要求が高まり、世界中で研究開発競争が激化している。この中心となるのが三次元積層半導体(3D-IC)である。本講演では、世界が注目する3D-ICの動向や、東北大で誕生し、我々が牽引してきた3D-ICを基盤とするシステム集積に焦点を当てた世界初の研究開発拠点「GINTI: Global INTegration Initiative」の成果を紹介する。GINTIは、300mmウエハを用いて最先端の3D-ICを一貫して柔軟に試作・製造できる国内唯一、世界でも稀なクリーンルームを東北大学近隣のパナソニック仙台工場(宮城県名取市)内に整備した。特に、世界規模で共同研究などを展開する先駆的なGINTIの試作実績やGINTIの多様な開発技術と活動現況について詳しく言及する。

開催：令和3年 11月19日(金)

時間：15:30~17:00

開催方式：オンラインによる配信

(パソコン・タブレット・スマートフォンで視聴できます)

申込方法：裏面のE-mailまたはwebによる申し込み方法をご覧ください

主催：東北大学 未来科学技術共同研究センター(NICHe)

協賛：日本工学アカデミー東北支部・北海道支部

参加
無料

東北大学未来科学技術共同研究センターは、産学連携を通して、新しい技術の開発と、その実用化を目指して活動しています。

未来科学オープンセミナー 申し込み方法

1. E-mailによる申し込み

参加ご希望の方は下記の情報をご記入の上、下記宛先までE-mailでお申込ください。

- ・団体名（会社名・学校名）
- ・御所属・学年
- ・御氏名
- ・Eメールアドレス
- ・その他連絡事項

（同じ御所属より複数名ご参加の場合は、上記情報を参加される全員分をお書き下さい。）

E-mail

mirai@niche.tohoku.ac.jp

申込先

東北大学未来科学技術共同研究センター
未来科学オープンセミナー 事務局 宛

2. webからの申し込み

参加ご希望の方は下記ページのフォームに入力してお申込ください。

アドレス

<https://www.niche.tohoku.ac.jp/opseminar.html>

お申込みいただいた方に、後日連絡用E-mailアドレスにご参加URL・視聴方法・事前資料をご送信いたします

※質疑応答につきまして

当日の質疑応答は、配信ソフトのチャット機能にお書込み、または事前に配布いたします資料をご確認いただき、事務局までメールをご送信ください。

〔締切〕 11月18日(木)